

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

488

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

08.06.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1	A00 B00
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	310		2	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		4	
C-RS-FR4-DS-2.40mm-070+070-TG150-HF	50201042	70	L2	5	
		2260			
		70	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	310		6	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		7	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		8	
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	9	

Dicke nach Verpressen

B00:

3090 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3410 µm

Dmin:

2770 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

3200 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3520 µm

Dmin:

2880 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

3056 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik